

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อ	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพประกอบ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ทฤษฎี	6
2.1 สารตัวนำวอดยีน	6
2.2 ทฤษฎี BCS	6
2.3 อุณหภูมิวิกฤต (T_c) ในสารตัวนำวอดยีน	8
2.4 ความหนาแน่นกระแสวิกฤต (J_c) ในสารตัวนำวอดยีน	9
2.5 โครงสร้างผลึกของสารตัวนำวอดยีนอุณหภูมิสูงระบบ Bi-Sr-Ca-Cu-O	11
2.6 Whiskers	14
2.7 การปลูก whiskers ตัวนำวอดยีนของ Bi-Sr-Ca-Cu-O	16
2.7.1 อัตราส่วนของสารเริ่มต้น	17
2.7.2 สารที่ใช้ปลูก whiskers	17
2.7.3 อุณหภูมิ	18
2.7.4 บรรยากาศของการปลูก whiskers	18
2.7.5 เวลาที่ใช้ในการปลูก whiskers	19
2.8 กระบวนการ Heat treatment	19
2.8.1 การเผาผง	19
2.8.2 การอัดเม็ด	19
2.8.3 กระบวนการ sinter	19
2.9 การ transition ของสาร	20
บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ วิธีทดลอง	21
3.1 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปลูก whiskers	21

	หน้า
3.1.1 สารเคมี	22
3.1.2 เครื่องซิงสาร	22
3.1.3 ครกบดสาร และ Alumina boat	23
3.1.4 อุปกรณ์ quench	23
3.1.5 เตาเผาสารและเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	24
3.1.6 เครื่องอัดเม็ดสาร	27
3.1.7 เครื่องตัดแต่งเม็ดสาร	28
3.2 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพพื้นผิวของ whiskers	28
3.2.1 กล้องจุลทรรศน์	28
3.2.2 กล้อง Optical microscope	29
3.2.3 กล้อง Scanning Electron Microscope	31
3.2.4 อุปกรณ์สำหรับวัดความสัมพัทธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิ	32
3.2.5 อุปกรณ์สำหรับวัดความหนาแน่นกระแสวิกฤติ (J_c)	33
3.3 วิธีทดลอง	34
3.3.1 วิธีปลูก whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+x}$ (2212)	35
3.3.2 วิธีเตรียมผงของสาร $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_4\text{Cu}_6\text{Pb}_y\text{O}_{10+x}$ ($y = 0.5$ และ 0)	37
3.3.3 วิธีปลูก whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_y\text{O}_{10+x}$ ($y = 0.5$ และ 0) ด้วยวิธี CAP	37
3.3.4 วิธีตรวจสอบการเกิดของ whiskers	40
3.3.5 วิธีตรวจสอบพื้นผิวของ whiskers	41
3.3.6 วิธีวัดขนาดของ whiskers	41
3.3.7 วิธีการติด contact	42
3.3.8 วิธีหาความสัมพัทธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers	43
3.3.9 วิธีวัดความหนาแน่นกระแสวิกฤติ (J_c) ของ whiskers	44

	หน้า
บทที่ 4 ผลการทดลอง	45
4.1 ผลการศึกษาลักษณะ ขนาด และพื้นผิวของ whiskers(2212)	45
4.1.1 ลักษณะการเกิดของ whiskers (2212)	46
4.1.2 ผลการวัดขนาดของ whiskers (2212)	47
4.1.3 ลักษณะพื้นผิวของ whiskers(2212)	47
4.1.4 ผลการวัดความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับ อุณหภูมิของ whiskers (2212)	48
4.2 ผลการศึกษาลักษณะ ขนาด และพื้นผิวของ whiskers (2223)	50
4.2.1 ผลการวัดขนาดของ whiskers (2223)	51
4.2.2 ผลการวัดความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับ อุณหภูมิของ whiskers (2223)	53
4.3 ผลการวัดความหนาแน่นกระแสจิกฤต (J_0) ของ whiskers	58
4.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ whiskers โดยการ X-ray ผ่าน กล้อง SEM	61
4.5 ผลการวิเคราะห์ whiskers โดยใช้เครื่อง x-ray diffraction	68
บทที่ 5 สรุป และวิเคราะห์ผลการทดลอง	72
5.1 ลักษณะ ขนาด และ พื้นผิวของ whiskers (2212)	72
5.2 ลักษณะ ขนาด และ พื้นผิวของ whiskers (2223)	73
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers	73
5.4 ความหนาแน่นกระแสจิกฤต(J_0)ของwhiskers	74
5.5 ผลการวิเคราะห์ XRD	74
5.6 สรุปผลการทดลอง	75
5.7 ข้อเสนอแนะ	76
เอกสารอ้างอิง	77
ภาคผนวก	79
ภาคผนวก ก	80
ภาคผนวก ข	82
ประวัติผู้เขียน	85

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1	แสดงองค์ประกอบของสารตัวนำยวดยิ่งระบบ Bi-Sr-Ca-Cu-O เฟส 2212 และ 2223	12
2.2	แสดงการเจริญเติบโตของ whiskers โดยวิธี VLS	15
2.3	แสดงวิธีการปลูก whiskers ของสารตัวนำยวดยิ่งBSCCO	17
4.1	แสดงคุณสมบัติวิกฤตของ whiskers ตัวอย่างที่เตรียมได้	58
4.2	แสดงพื้นที่หน้าตัดและความหนาแน่นกระแสวิกฤตของ whiskers ตัวอย่าง	60
5.1	แสดงการเปรียบเทียบผลการทดลองที่ให้กับของ Matsubara	72
5.2	แสดงการเปรียบเทียบผลการทดลองที่ให้กับของ Matsubara	73

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.1	แสดงวิวัฒนาการของการค้นพบสารตัวนำยิ่งยวดยิ่งอุณหภูมิสูง	2
1.2	แสดงโครงสร้างผลึกของ $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_{n-1}\text{Cu}_n\text{O}_x$ ที่มีค่า $n = 2$ และ 3	3
2.1	แสดงค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิ	8
2.2	แสดงสารตัวนำยิ่งยวด type I ที่มีรูปร่างทรงกระบอก ซึ่งกระแสจะหนาแน่นที่บริเวณผิว	10
2.3	แสดงการนำกระแสของตัวนำธรรมดา กับตัวนำยิ่งยวด type I และ type II	11
2.4	แสดงโครงสร้างผลึกของสารตัวนำยิ่งยวดของระบบ Bi-Sr-Ca-Cu-O เฟส 2223, 2212 และ 2201	13
2.5	แสดงไดอะแกรมการปลูก whiskers ด้วยวิธี Vapour-Liquid-Solid (VLS) ของสาร InAs wire nucleated โดยอะตอมของ As	14
2.6	แสดงลักษณะการเกิดของ whiskers ตามโมเดล Tip Growth	16
2.7	แสดงลักษณะการเกิดของ whiskers ตามโมเดลของ End Growth	16
2.8	แสดงกราฟของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับค่าของ y ใน Bi_2Pb_y	18
2.9	แสดงการปลดปล่อยรังสีเอ็กซ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ transition	20
3.1	แสดงสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง	22
3.2	แสดงเครื่องตั้งสาร	22
3.3	แสดงครกบดสารและอุปกรณ์	23
3.4	แสดงลักษณะของแผ่นทองแดงที่ใช้ในการ Quench สาร	23
3.5	แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการหลอมเหลวสารตัวอย่าง และช่วยในการ quench สาร	24
3.6	แสดงลักษณะรูปร่างภายนอกและขนาดของเตาเผาสาร	24
3.7	แสดงส่วนประกอบภายในของเตาเผาสาร	25
3.8	แสดงส่วนประกอบของไส้เตาเผาสาร	25
3.9	แสดง Temperature controller	26
3.10	แสดง Maxthermo temperature controller	26
3.11	แสดงส่วนประกอบของระบบเตาเผาสารและวงจรที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิ	26

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
3.12 แสดงอุปกรณ์สำหรับการขึ้นรูปสารเป็นเม็ด	27
3.13 แสดงเครื่องตัดแต่งเม็ดสาร	28
3.14 แสดงกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา กำลังขยาย 40 เท่า	28
3.15 แสดงกล้อง Optical microscope กำลังขยาย 50, 100 และ 500 เท่า	29
3.16 แสดงไดอะแกรมการทำงานของกล้อง Optical microscope	30
3.18 แสดงกล้อง Scanning Electron Microscope	31
3.19 แสดงไดอะแกรมการทำงานของกล้อง Scanning Electron Microscope	31
3.20 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้านทานไฟฟ้า กับ อุณหภูมิของ whiskers	33
3.21 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความหนาแน่นกระแสวิกฤตของ whiskers	34
3.22 แสดงการ set อุณหภูมิเตา	36
3.23 แสดงการ set ตำแหน่งการวาง ท่อกาซออกซิเจน	36
3.24 แสดงขั้นตอนการปลูก whiskers (2223)	38
3.25 เงื่อนไขการ quench สาร $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+x}$ (2212)	39
3.26 เงื่อนไขการ growth whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+x}$ (2212)	39
3.27 เงื่อนไขการ calcine สาร $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_4\text{Cu}_6\text{Pb}_y\text{O}_x$ ($y = 0.5$ และ 0)	39
3.28 เงื่อนไขการเผาเม็ด(sintering) สาร $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_y\text{O}_{10+x}$ ($y = 0.5$ และ 0)	40
3.29 เงื่อนไขการanneal whiskers(2212) ในผงสาร $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_4\text{Cu}_6\text{Pb}_y\text{O}_x$ ($y = 0.5$ และ 0)	40
3.30 แสดงการติด contact	42
3.31 แสดงไดอะแกรมการทำงานของอุปกรณ์วัดความสัมพันธ์ระหว่างความต้าน ทาน ไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers	43
3.32 แสดงไดอะแกรมการทำงานของอุปกรณ์วัดความหนาแน่นกระแสวิกฤตของ whiskers	44

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
4.1	แสดงผงของสาร $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+x}$ ที่บรรจุอยู่ใน alumina boat ก่อนทำการหลอมเหลว	45
4.2	แสดงลักษณะของ glassy plate ที่ได้หลังทำการ quench	45
4.3	แสดงลักษณะพื้นผิวของ glassy plate ที่เกิด whiskers ซึ่งถูกถ่ายด้วยกล้อง Scanning Electron microscope	46
4.4	แสดงลักษณะการเกิดของ whiskers ซึ่งถูกถ่ายด้วยกล้อง Scanning Electron microscope	46
4.5	แสดงลักษณะการเกิดของ whiskers ถ่ายภาพด้วยกล้อง Scanning electron microscope	47
4.6	แสดงลักษณะพื้นผิวของ whiskers(2212) ถ่ายภาพด้วยกล้อง Scanning Electron microscope ตัวอย่างที่ 1	48
4.7	แสดงลักษณะพื้นผิวของ whiskers(2212) ถ่ายภาพด้วยกล้อง Scanning Electron microscope ตัวอย่างที่ 2	48
4.8	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers (2212) ตัวอย่างที่ 1	49
4.9	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers (2212) ตัวอย่างที่ 2	49
4.10	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers (2212) ตัวอย่างที่ 3	49
4.11	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers (2212) ตัวอย่างที่ 4	50
4.12	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers (2212) ตัวอย่างที่ 5	50
4.13	แสดงลักษณะการวาง whiskers(2212) ในผงสาร $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_4\text{Cu}_6\text{Pb}_y\text{O}_{10+x}$ ($y = 0.5$ และ 0)	51
4.14	แสดงผงของสาร $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_4\text{Cu}_6\text{Pb}_y\text{O}_{10+x}$ ($y = 0.5$ และ 0) โดย calcine ผงที่ 820°C	51
4.15	แสดงลักษณะพื้นผิวของ whiskers(2223) ถ่ายภาพด้วยกล้อง Scanning	52

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
4.16	แสดงลักษณะพื้นผิวของ whiskers(2223) ถ่ายภาพด้วยกล้อง Scanning Electron microscope ตัวอย่างที่ 2	52
4.17	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_{0.5}\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 1	53
4.18	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_{0.5}\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 2	53
4.19	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_{0.5}\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 3	54
4.20	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_{0.5}\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 4	54
4.21	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_{0.5}\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 5	54
4.22	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_{0.5}\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 6	55
4.23	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_{0.5}\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 7	55
4.24	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 1	56
4.25	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 2	56
4.26	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 3	56
4.27	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 4	57
4.28	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 5	57
4.29	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 6	57

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
4.30	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+x}$ ตัวอย่างที่ 7	58
4.31	แสดงความหนาแน่นกระแสวิกฤตของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+x}$	59
4.32	แสดงความหนาแน่นกระแสวิกฤตของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_{0.5}\text{O}_{10+x}$	60
4.33	แสดงความหนาแน่นกระแสวิกฤตของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+x}$	60
4.34	แสดง X-ray ด้วยกล้อง SEM ของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+x}$	61
4.35	แสดง X-ray ด้วยกล้อง SEM ของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_{0.5}\text{O}_{10+x}$	62
4.36	แสดง X-ray ด้วยกล้อง SEM ของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+x}$	63
4.37	แสดงภาพตัดขวางของผิวของ glassy plate ที่เกิด whiskers ซึ่งถ่ายด้วยกล้อง SEM	64
4.38	แสดง X-ray ด้วยกล้อง SEM ที่บริเวณ A	65
4.39	แสดง X-ray ด้วยกล้อง SEM ที่บริเวณ B	66
4.40	แสดง X-ray ด้วยกล้อง SEM ที่บริเวณ C	67
4.41	แสดง XRD ของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+x}$	69
4.42	แสดง XRD ของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{Pb}_{0.5}\text{O}_{10+x}$	70
4.43	แสดง XRD ของ whiskers $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+x}$	71